



SPARC T3-4 서버

미드레인지 컴퓨팅의 경제성 향상

주요 기능 및 이점

- 미드레인지 시스템의 가용성과 안정성을 바탕으로 뛰어난 처리 성능 제공
- 최고 512개의 동시 컴퓨팅 스레드와 512GB(8GB DIMM)의 메모리를 통해 이전 세대 제품 보다 2배 향상된 뛰어난 처리 성능 제공
- 표준 데이터센터 랙에서 8대의 T3-4 서버를 장착한 고밀도 설계를 통해 뛰어난 컴퓨팅 성능 제공
- Oracle VM Server for SPARC(이전의 Sun Logical Domains) 및 Oracle Solaris Containers에서 내장된 가상화 기술을 통해 활용도를 높이고 비용을 절감하며 워크로드를 통합
- 미션 크리티컬한 백오피스 애플리케이션에 탁월한 성능과 가용성 제공
- 통합 온칩 암호 가속화 기술
- 어떠한 변경 없이 Oracle Solaris 10에서 Oracle Solaris 8 및 9 OS 애플리케이션을 실행
- 이전 세대 제품 보다 I/O 처리 성능이 4배 향상된 I/O 확장 유닛을 통해 최고 16개의 PCI Express Module 슬롯을 지원하는 등 뛰어난 I/O 성능 제공

Oracle SPARC T3-4 서버는 미션 크리티컬 애플리케이션의 가상화 및 통합을 지원하는 통합 설계를 기반으로 대용량 메모리와 뛰어난 안정성, 가용성 및 보안성을 지원하는 등 미드레인지 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 또한, 내장된 가상화 기술과 함께 뛰어난 처리 성능 및 컴퓨팅 밀도를 제공하기 때문에 대규모 미션 크리티컬 애플리케이션을 구축할 때 매우 효율적인 플랫폼이라 할 수 있습니다.



그림 1: SPARC T3-4 서버는 미드레인지 컴퓨팅의 경제성을 향상시킵니다.

제품 개요

SPARC T3-4 서버는 오라클이 새롭게 선보이는 4소켓, 5RU 모듈식 T-series 서버입니다. 16코어 SPARC T3 프로세서를 장착한 업계 최초의 512스레드 범용 서버입니다.

64개의 코어, 512개 스레드, 512GB 메모리(8GB DIMM) 및 16개의 PCIe G2 슬롯을 갖추고 있는 SPARC T3-4 서버는 웹 서비스, 애플리케이션 레이어 및 엔터프라이즈 애플리케이션 같은 고객 환경에 탁월한 처리 성능과 효율성을 제공합니다. 특히 CRM, ERP 및 SCM 같은 SPARC 워크로드의 통합을 모색하고 있고 데이터베이스, 애플리케이션 서버 및 웹 서비스를 지원하고 있는 고객들에게 최적화된 제품입니다.

추가 비용 없이 내장된 Oracle VM Server for SPARC(이전의 Sun Logical Domains) 가상화 기술은 서버당 최고 128개의 분리된 도메인을 제공합니다.

SPARC T3-4 서버는 혁신적인 설계와 안정성 기능, 그리고 통합 온칩 10Gigabit Ethernet, 디스크 컨트롤러 및 암호화 가속화 같이 보다 적은 부품을 사용할 수 있는 지능적인 통합 설계를 바탕으로 업타임을 대폭 늘리고 예기치 못한 수리 작업을 줄임으로써 안전성과 신뢰성이 뛰어난 플랫폼을 제공합니다.

SPARC T3-4 서버 사양

주요 적용 분야	
<ul style="list-style-type: none"> • CRM, ERP, SCM 같은 엔터프라이즈 애플리케이션 • 하나로 통합된 엔터프라이즈 웹 및 애플리케이션 계층 인프라 • 미디어 애플리케이션 • 웹 서비스 • Java 애플리케이션 및 가상화 	
아키텍처	
프로세서	
<p>1.65GHz에서 2 ~ 4개의 SPARC T3 프로세서 지원, 프로세서당 16개 코어. 기타 주요 프로세서 기능:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 프로세서당 16개의 FPU(Floating-Point Unit), 코어당 1개 • 새로운 Kasumi Bulk 알고리즘을 이용한 온보드 암호화 기술. 12개 내장 암호 지원 업계 표준 암호: DES, 3DES, AES, RC4, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MD5, RSA to 2048 key, ECC, CRC32 	
프로세서당 캐시	
6 MB 통합 L2	
주 메모리	
<p>최대 512GB(8GB DIMM) 4GB 및 8GB DIMM 지원</p>	
시스템 아키텍처	
SPARC V9 아키텍처, ECC 보호	
표준/통합 인터페이스	
<ul style="list-style-type: none"> • 네트워크. 2개의 QSFP 포트 옵션(10G XAUI 네트워크), 4개의 1G 네트워크 포트(2개의 Kawela NIC) • 확장 버스. 8개의 2x 8레인 PCIe 슬롯 • 포트. 4개의 USB 2.0 포트, 1개의 RJ45 직렬 관리 포트, 콘솔 직렬 포트(앞면과 한쌍), 콘솔 10/100 네트워크 포트, VGA 포트 	
대용량 스토리지 및 미디어	
내장 디스크	최고 8개의 300GB 2.5인치 SAS 드라이브
외장 스토리지	오라클은 세계적으로 정평이 나 있는 서비스 및 지원과 함께 동급 최강의 혁신적인 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 완벽한 제품 라인을 제공하고 있습니다. 보다 자세한 정보를 원하시면, oracle.com/storage 로 문의하여 주십시오.
전원 공급장치	
<ul style="list-style-type: none"> • 4개의 핫 스왑형 AC 2,060 W 리던던트(2 + 2) 전원 공급장치 • 작동 시 최대 입력 전류: TBD • 작동 시 최대 입력 전력: TBD 	
주요 RAS 기능	
<ul style="list-style-type: none"> • 핫 플러그형(Hot-pluggable) 디스크 드라이브 • 리던던트 핫 스왑형 전원 공급장치 및 팬 • 환경 모니터링 • 오류 복구 및 패리티(parity) 검사 메모리 • 간편한 구성 요소 교체 • RAID 0 및 1을 지원하는 통합 디스크 컨트롤러 • Electronic prognostics 	

소프트웨어	
운영체제	Oracle Solaris 10 OS 10/09
포함 소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> Oracle Solaris 10 10/09 사전 탑재 Oracle VM Server for SPARC 2.0 Electronic Prognostics V1.1
가상화	
Oracle VM Server for SPARC (이전의 Sun Logical Domains) 및 Oracle Solaris Containers는 단일 서버에서 128개 버추얼 시스템의 유연성과 위력을 제공합니다.	
환경	
작동 온도	<ul style="list-style-type: none"> 5°C~35°C (41°F~95°F) 최대 온도 저하: 900미터 1°C/300미터(1.6°F/1,000피트)
비작동 온도	<ul style="list-style-type: none"> 40°C~65°C (-40°F~149°F), 최대 고도 40,000피트
작동 상대 습도	<ul style="list-style-type: none"> 10%~90%, 비응결, 27°C 습구 온도
비작동 상대 습도	<ul style="list-style-type: none"> 93%, 비응결, 38°C (100.4°F) 습구 온도
작동 고도	<ul style="list-style-type: none"> 0미터~3,000미터(0피트~10,000피트)
비작동 고도	<ul style="list-style-type: none"> 0미터~12,000미터(0피트~1,219,200.00피트)
노이즈 방출	<ul style="list-style-type: none"> TBD
전력 및 냉각	<ul style="list-style-type: none"> TBD
규정(다음과 같은 요건을 충족)	
<ul style="list-style-type: none"> 안전: UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 CB Scheme(각 국가마다 편차 있음), IEC 825-1, 2 CFR 21 part 1040, CNS 14336 EMI/EMC: EN 55022 Class A, 47 CFR 15B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, AS/NZ 3548 Class A, CNS 13438 Class A, KSC 5858 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 내성: EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 규정: CE, FCC, ICES-003, C-Tick, VCCI, GOST-R, BSMI, MIC, UL/cUL, UL/S-Mark 	
크기 및 출하 중량	
<ul style="list-style-type: none"> 높이: 219mm (8.62인치), 5RU 너비: 445mm (17.5인치) 깊이: 700mm(70.10인치) 무게: 최대 79 kg(175lbs.), 랙 마운트형 키트 제외 	

보증

본 제품에 대한 오라클의 전 세계적인 보증 지원 정보는 oracle.com/sun/warranty에서 확인할 수 있습니다.

서비스

본 제품에 대한 오라클의 서비스 프로그램은 oracle.com/sun/services에서 확인할 수 있습니다.

문의처

오라클의 SPARC T3-4에 대한 보다 자세한 정보는 www.oracle.com/kr에서 확인하거나 080-2194-114로 전화하여 한국오라클 담당자에게 문의하십시오.



Oracle is committed to developing practices and products that help protect the environment

Copyright © 2010, Oracle 및/또는 그 계열사. All rights reserved.

본 문서는 정보의 목적으로만 사용되며 일체의 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서는 오류에 대해 책임지지 않으며 특정 목적에 대한 적격성 및 적합성과 관련된 묵시적 보증 및 계약 조건을 포함해서 명시적, 묵시적 기타 모든 보증 또는 계약 조건에 의해 구속 받지 않습니다. 오라클은 본 문서와 관련해 어떠한 법적 책임도 지지 않으며, 본 문서로 인해 직간접적인 어떠한 계약 구속력도 발생하지 않습니다. 본 문서는 Oracle의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전자적 또는 기계적) 또는 목적으로도 복제되거나 배포할 수 없습니다.

Oracle 및 Java는 오라클 및/또는 그 계열사의 등록 상표입니다. 기타 명칭은 해당 소유업체의 상표입니다.

AMD, Opteron, AMD 로고 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 또는 등록 상표입니다. Intel 및 Intel Xeon은 Intel Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며, SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 라이선스되는 등록 상표입니다. 0410

Hardware and Software
Engineered to Work Together